

<<微机电系统集成与封装技术基础>>

图书基本信息

书名：<<微机电系统集成与封装技术基础>>

13位ISBN编号：9787111209171

10位ISBN编号：7111209176

出版时间：2007-3

出版时间：机械工业

作者：姜文忠

页数：245

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微机电系统集成与封装技术基础>>

内容概要

《微机电系统集成与封装技术基础》主要介绍微机电系统集成与封装技术。全书包括三个部分，分别为：微机电系统集成技术基础、微机电系统封装技术基础、微机电系统集成与封装的应用。

书中系统地叙述了微机电系统集成设计与封装技术的概念、体系结构、典型系统、所用的先进技术以及未来的发展趋势；书中对近年来国外微机电系统集成与封装最新技术动态加以归纳总结，对相关理论、技术进行深刻的阐述与分析。

并以大量、详实的案例，在完整的微机电系统集成与封装知识体系下，面向应用，服务社会。

《微机电系统集成与封装技术基础》可供微电子、微电系统等领域专业研究以及机械、物理和材料方面研究人员参考，亦可作为相关专业高年级本科生、研究生教材。

<<微机电系统集成与封装技术基础>>

书籍目录

前言第1篇 微机电系统集成技术基础第1章 引言1.1 微系统与微机电系统1.2 微机电系统封装的背景1.3 微机电系统集成与封装中的重要问题1.4 MEMS封装技术1.5 微组装技术1.6 微机电系统封装测试标准1.7 小结参考文献第2章 微机电系统集成与封装设计基础2.1 封装设计的系统分析2.2 微机电系统封装的三个等级2.3 微机电系统封装的设计与工艺流程2.4 基本MEMS封装过程2.5 一些特殊的MEMS封装问题2.6 最新研究热点2.7 小结参考文献第3章 微系统热管理技术3.1 热管理的概念3.2 微系统热管理的重要性3.3 热管理的理论基础3.4 IC和PCB的热模型3.5 热管理技术参考文献第4章 微机电系统封装主动制冷与热仿真技术第5章 微传感器集成封装技术第2篇 微机电系统封装技术第6章 引线键合技术第7章 倒装芯片技术第8章 聚合物键合第9章 CSP与BGA技术第10章 多芯片组件(MCM)第3篇 微机电系统封装的应用第11章 微机电系统封装在生命科学中的应用第12章 微机电系统封装在通信及相关领域中的应用第13章 微机电系统封装在军事上的应用及未来发展方向

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>